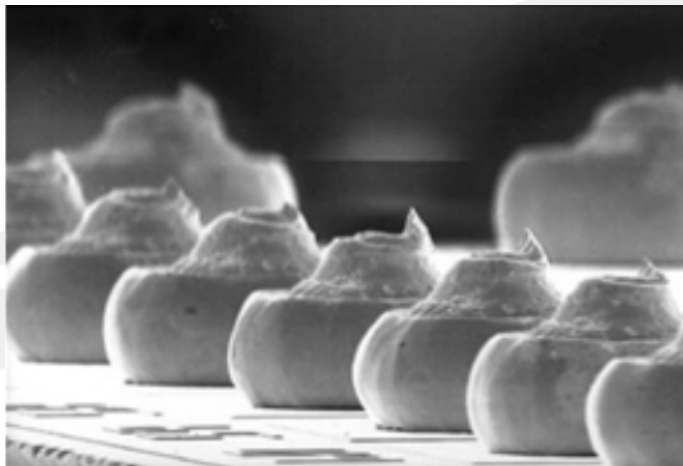


POST PROCESS SUR CHIP



DIAMÈTRE : 60 - 120 μ m
HAUTEUR : 45 - 60 μ m
CADENCE : JUSQU'À 35 BUMPS/SEC

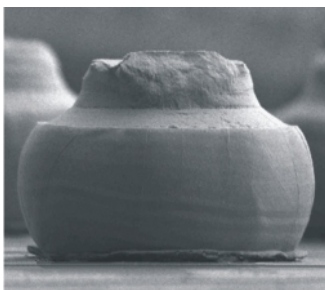
BUMPING SUR :

- WAFER JUSQU'À 12"
- BLUE FOIL
- WAFER SCIÉ
- UNITAIRES

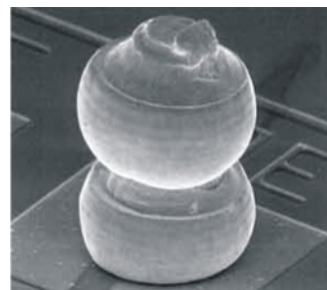
STANDARD BUMP



ACCU BUMP

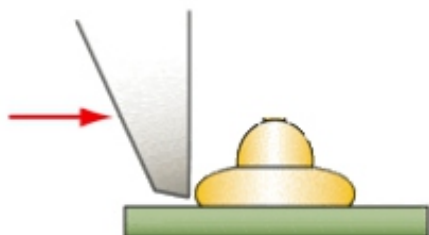


STACKED ACCU BUMP



HYBRID SA EST À MÊME D'EFFECTUER LE BUMPING DE CHIPS SUR WAFER. LA FORME DU BUMP EST DÉFINIE EN COLLABORATION AVEC LE CLIENT POUR QU'IL CORRESPONDE AUX SPÉCIFICITÉS D'ASSEMBLAGE DU CHIP.

SHEAR TEST



APPLICATION DE LA FORCE JUSQU'À RUPTURE DU BUMP